



SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STBP148-7R1-A332

Thin Film Planar Filters

## 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

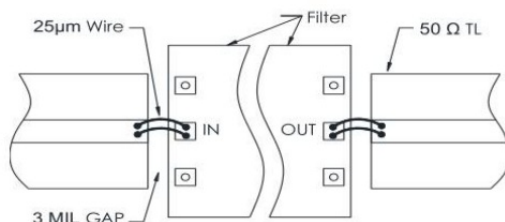
技术要求,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

| 参数   | 最小            | 典型    | 最大   | 单位  |
|------|---------------|-------|------|-----|
| 中心频率 |               | 14.75 |      | GHz |
| 工作频率 | 11.2          |       | 18.3 | GHz |
| 中心损耗 |               | 2.3   | 2.8  | dB  |
| 带内波动 |               | 0.8   | 1.0  | dB  |
| 回波损耗 | 12            | 14    |      |     |
| 带外抑制 | @5.0-7.8GHz   | 40    | 45   | dBc |
|      | @20.9-27.8GHz | 40    | 45   | dBc |
|      | @DC-5.0GHz    | 60    | 65   | dBc |
|      | @27.8-35.8GHz | 60    | 65   | dBc |

环境要求

|        |                                             |     |
|--------|---------------------------------------------|-----|
| 最大输入功率 | 35                                          | dBm |
| 工作温度   | $-55^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$  |     |
| 储存温度   | $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ |     |

推荐装配图

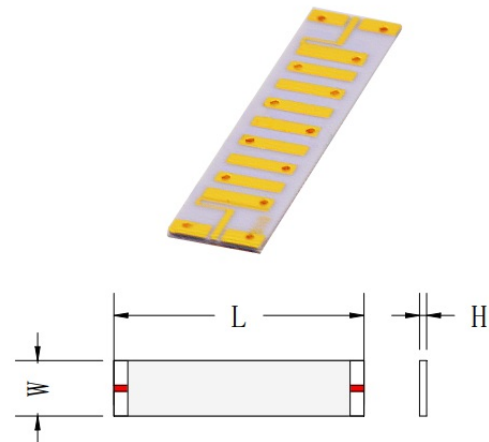


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或铝铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C),载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

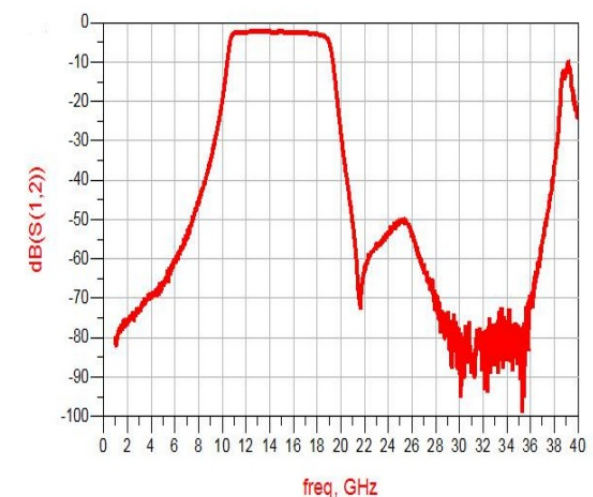
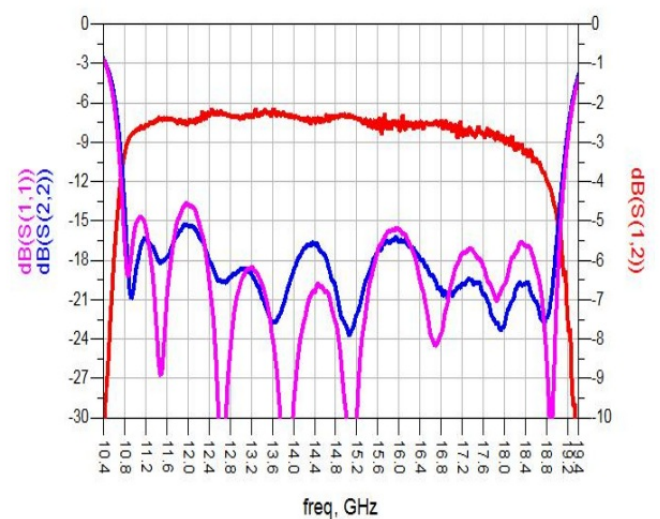
| 电路板 Rogers 5880, 10mil 厚 <sup>①</sup>             | 电路板 Rogers 4350, 10mil 厚 <sup>②</sup> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   |                                       |
| 注: T型图形顶端基板白边 0.1mm; 频率 10GHz 以下无需匹配 <sup>③</sup> |                                       |

外形图



| 外形尺寸 | L   | W   | H     | 单位 |
|------|-----|-----|-------|----|
|      | 7.0 | 3.0 | 0.254 | mm |

典型曲线,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。